

圣戈鲁 **SGLTEK** 8821X/8821 双组份导电银胶

不含溶剂，常温固化，高强度导电粘结



可以在较低的温度固化，实现导电连接
为难以焊接的材料提供高强度的导电粘结

常温固化型

1. 环氧导电银胶，粘结强度高
2. 可密封性粘结，不含挥发性溶剂
3. 可较低温度固化，20~80°C固化
4. 可粘结金属、石墨、陶瓷、玻璃
5. 耐温较高，-50~180°C工作
6. 现配现用，适合长期存放

圣戈鲁8821X/8821 产品应用场景

双组份导电银胶：金属,陶瓷,石墨等多种材料的高强度粘结



金属材料

部分产品的元器件不耐高温
可以使用双组份导电银胶进行
粘合，实现导电粘结。

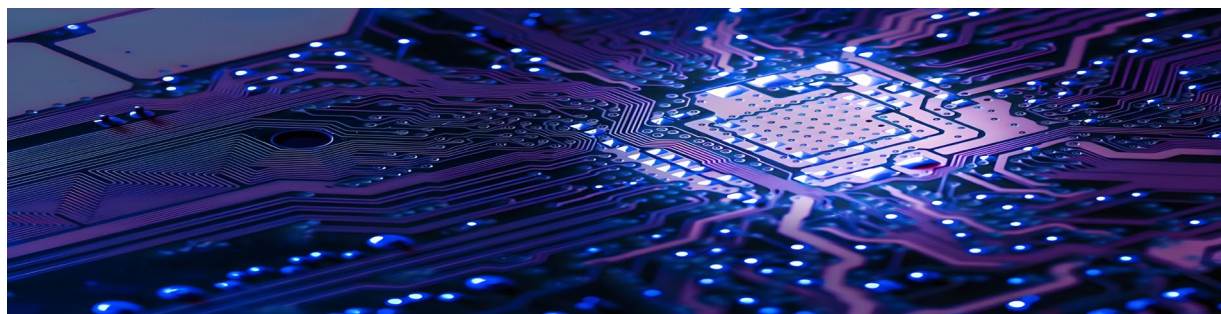
- ✓温控阀芯
- ✓医疗靶材
- ✓医疗器械



非金属材料

环氧树脂为基体材料，可以
粘结石墨，导电玻璃，陶瓷等
材料，解决了不能焊接的问题。

- ✓石墨双极板
- ✓陶瓷、玻璃
- ✓声波换能器



Two-Component Silver Conductive Adhesive

圣戈鲁**SGLTEK** 8821X与8821区别

8821X适合要求高的使用环境；8821适合工业化大生产,性价比高

8821
价格较低

高温下导电较好

较高的银含量使得高温下抗氧化能力更强，适用于要求更高的一些领域。广泛应用于各类电子电器行业，性能稳定。

VS

有效降低成本

通过铜颗粒表面镀银的技术降低银的使用量，能够保证有效的导电能力并且大幅降低成本，适合工业化大规模的使用。

8821X
导电较好



工业化大规模使用



要求较高的领域使用

8821X & 8821的选择

圣戈鲁SGLTEK 8821X双组份导电银胶

Technical Data Sheet

产品概述： 该产品属于双组份环氧导电银胶。含银量较高，高温下更稳定，常温固化；能够代替锡焊，对金属，陶瓷，石墨, 玻璃等材料进行高强度导电粘结。



产品指标：

项目	单位	A（甲组份）	B（乙组份）
外观	-	银色膏状	浅黄色液体
粘度	mpa·s（25℃）	14000~15000	400~560
密度	g/cm ³	2.0~2.3	0.98~1.00
混合后粘度	mpa·s（25℃）	12000~13000	
混合比例	-	A:B=10:1（重量比）	
可操作时间	hr（25℃）	1~1.5小时	
固化时间	hr（25℃）	25℃*24小时固化，80℃*1小时固化	
项目	单位	指标	测试方法
导热系数	W/m·k	2.5~3.0	GB/T 3399
体积电阻率	Ω·cm	10 ⁻³ ~10 ⁻⁴	四探针
工作温度	℃	-55~ +180	进行了3次循环，胶块不应开裂，性能仍符合要求
包装	11g/套 针管装；100g/套 瓶装		
产品保质期	20~25℃，12个月（密封），针管装A组份建议冷藏，防止银粉树脂分层		

圣戈鲁SGLTEK 8821双组份导电银胶

Technical Data Sheet

产品概述： 该产品属于双组份环氧导电银胶。银铜粉体可以有效降低成本，适合工业化大规模用；能够代替锡焊，对金属，陶瓷，石墨, 玻璃等材料进行高强度导电粘结。



产品指标：

项目	单位	A（甲组份）	B（乙组份）
外观	-	银铜色膏状	浅黄色液体
粘度	mpa·s（25℃）	10000~12000	400~560
密度	g/cm ³	2.0~2.3	0.98~1.00
混合后粘度	mpa·s（25℃）	9000~10000	
混合比例	-	A:B=10:1（重量比）	
可操作时间	hr（25℃）	1~1.5小时	
固化时间	hr（25℃）	25℃*24小时固化，80℃*1小时固化	
项目	单位	指标	测试方法
导热系数	W/m·k	2.5~3.0	GB/T 3399
体积电阻率	Ω·cm	10 ⁻³ ~10 ⁻⁴	四探针
工作温度	℃	-55~+180	进行了3次循环，胶块不应开裂，性能仍符合要求
包装	11g/套 针管装；100g/套 瓶装		
产品保质期	20~25℃，12个月（密封），针管装A组份建议冷藏，防止银粉树脂分层		